



第 25 届电子封装技术国际会议

2024年8月7-9日 中国·天津

<http://www.icept.org>

演讲题目: 智算中心光互连技术趋势

演讲人: 张源 专家级讲师

演讲摘要:

随着 2023 年底 Open AI ChatGPT3.5 发布, 随后多家跟进, 生成式 AI 正式进入应用时代。大模型训练算力需求激增, 智算中心进入爆发式增长, 对数据中心网络互联提出了大带宽、低延迟、智管理等更高挑战。促使光互连技术升级换代加快。

本文从 AI 的发展需求出发, 讲述智算中心及其网络的演进与挑战, 由此如何驱动光互连技术快速迭代。另外, 阐述说明光互连技术趋势给光电封装带来的关键技术挑战, 提出 800G+可插拔光模块、CPO、XPU OIO 共技术平台建设的建议。

演讲大纲:

- 1) 生成式 AI 时代, 赋予电子产品新动能
- 2) 智算中心网络的演进与挑战
- 3) 智算中心光互连技术趋势
- 4) 光电封装共平台的关键技术

适合对象:

封装工程师、光电工程师

演讲人简介:

从业二十多年, 一直从事先进电子材料及工艺的创新研究。曾在知名公司任职二十余年, 做为首任 leader 带领创建 PCB、SiP 封装工艺技术业务及团队, 曾任电子材料研发团队的技术首席; 并担任过网络及光电板级工程领域的首席规划师, 规划并开发过多款领先全球的关键部件及技术。一直热心板级及封装标准和行业活动, 曾任 IPC 协会 7-31bCN 中国区委员会首任主席, 组织 610CN 等标准开发。现在出于热爱, 持续板级和封装工程领域的行业探索与学习, 参与行业标准及协会等工作, 并做为个人讲师为行业服务。